

Dünnschichtmetallisierung: Ti - Ni - Au

Substrat	ANCeram Aluminiumnitrid	
Oberflächenqualität	Standard, $R_a \leq 0.6 \mu\text{m}$ poliert, $R_a < 0.1 \mu\text{m}$	DIN 41850 bzw. 4768
Metallisierung	Titan-Nickel-Gold (gesputtert)	
Geometrie	Vollflächig oder nach Kundenwunsch	
Schichtdicken	Ti $0.3 \mu\text{m}$ Ni $0.2 \mu\text{m}$ Au $2,5 \mu\text{m}$, minimal $0,1 \mu\text{m}$	
min. Leiterbahnabstand	$80 \mu\text{m}$	
min. Leiterbahnbreite	$100 \mu\text{m}$	
Flächenwiderstand	$20 \pm 4 \text{ m}\Omega / \square$	DIN 41850
Bondbarkeit	Aluminium-Dünndraht, US-Bonden, z.B. AlSi1, $25 \mu\text{m}$	DIN IEC 47 (CO) 760

Die genannten Daten und Empfehlungen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen, bedingt durch Produktverbesserungen und Weiterentwicklungen sind möglich. Kundenspezifische Anpassungen und Ausführungen sind auf Wunsch machbar.

Stand 06/99